

Formulaire de demande de découpe (lien pour l'intranet)

Lors de la découpe à la scie DISCO DAD 321, les dispositifs sont collés sur un film adhésif, maintenus par le vide et découpés avec une lame annulaire refroidie par eau.
L'enceinte n'est pas hermétique.

Nous avons impérativement besoin des informations suivantes afin de réaliser votre découpe et nous vous demandons :

- de joindre un plan à l'échelle, avec toutes les côtes de découpe
- de positionner vos dispositifs sur le substrat dans un réseau orthogonal (découpe de part et d'autre du wafer)
- de matérialiser les repères de découpe sur le substrat par des motifs parfaitement visibles : de préférence croix d'alignement (métal ou gravure) plutôt que des lignes en métal. La largeur du trait des croix d'alignement devra être de 100 microns sur 800 microns de long.
- de nous transmettre toutes les informations « sécurité » possibles ainsi que la compatibilité avec l'eau sur tous les matériaux utilisés autres que ceux de la liste suivante :
Wafers : silicium, quartz, verre, niobate de lithium fournis par la centrale MIMENTO.
Dépôt : or, chrome, aluminium, titane, platine, argent, cuivre, nickel fournis et déposés dans la centrale MIMENTO.

Nous vous demandons également de nous contacter pour connaître la faisabilité de la découpe en tout début de projet.

Sans toutes ces informations, la découpe ne sera pas réalisée.

Fiche de demande de découpe, présente sur le site de réservation de la salle blanche :

Nom du projet :

Nom et prénom :

Numéro de téléphone :

Nature du substrat :

Nombre de substrat :

Epaisseur du substrat :

Nature et épaisseur de tous les matériaux déposés sur le substrat :

Profondeur de découpe :

Nombre de traits de découpe :

Est-ce une découpe polissage pour le Niobate de lithium ou le Silicium ? :

Commentaires et recommandations (facultatifs) :